

奇景光電公佈自結 2018 年第一季度合併財務報表 及第二季展望

2018 年第一季度 營收淨額達法說會預估高標 毛利率則優於法說會預估
預估 2018 年第二季：營收較上一季增加 9%至 14% 毛利率約 23%左右

- 2018 年第一季度營收淨額為 1 億 6,290 萬美元，較上一季減少 10.1%，較去年同期增加 4.9%，達法說會預估高標
- 2018 年第一季度毛利率為 22.5%，較上一季減少 2.1 個百分點，優於法說會預估，較去年同期減少 0.6 個百分點
- 2018 年第一季度車用顯示器季營收近 2,500 萬美元，再創歷史新高，占驅動 IC 營收比例約 20%
- 2018 年第一季度稅後淨損為 280 萬美元，較上一季稅後淨利減少 112.0%，較去年同期稅後淨利減少 332.6%，優於法說會預估；2018 年第一季度每 ADS 淨損為 1.6 美分，亦較預估為優，上一季每 ADS 盈餘為 13.6 美分，去年同期每 ADS 盈餘為 0.7 美分
- 預估 2018 年第二季，營收較上一季增加 9%至 14%，毛利率約 23%左右，每 ADS 盈餘為 0 至 1 美分（約新台幣 0 至 0.29 元）之間

【台南，2018 年 5 月 10 日】奇景光電（納斯達克代號：HIMX）今日公佈自結 2018 年第一季度合併財務報表，及第二季展望。奇景 2018 年第一季度營收淨額達法說會預估高標，獲利情況及毛利率，則優於法說會預估。

2018 年第一季度自結財報

2018 年第一季度營收淨額 1 億 6,290 萬美元（約新台幣 47 億 7,600 萬元*），較上一季 1 億 8,110 萬美元（約新台幣 54 億 4,700 萬元**）減少 10.1%，較去年同期 1 億 5,520 萬美元（約新台幣 48 億 4,300 萬元***）增加 4.9%，達法說會預估高標。第一季毛利率為 22.5%，較上一季 24.6%減少 2.1 個百分點，優於法說會預估，較去年同期 23.1%減少 0.6 個百分點。

2018 年第一季度稅後淨損為 280 萬美元（約新台幣 8,300 萬元*），較上一季稅後淨利 2,350 萬美元（約新台幣 7 億零 800 萬元**）減少 112.0%，較去年同期稅後淨利 120 萬美元（約新台幣 3,800 萬元***）減少 332.6%。第一季每 ADS 淨損為 1.6 美分（約新台幣 0.47 元*），上一季每 ADS 盈餘為 13.6 美分（約新台幣 4.09 元**），去年同期每 ADS 盈餘為 0.7 美分（約新台幣 0.22 元***）。

2018 年第一季度毛利率分析

2018 年第一季度毛利率 22.5%，較法說會預估略優 0.5 個百分點，但較上一季減少 2.1 個百分點，第一季毛利率下降原因是晶圓級光學鏡頭（WLO，wafer level optics）主要客戶訂單減少，因為產能利用率降低，導致每單位設備折舊和製造成本上升。

2018 年第二季財測預估

奇景預期 2018 年第二季，所有大尺寸、中小尺寸及非驅動 IC 三大產品部門整體將較上一季出現反彈。奇景預估，2018 年第二季營收較上一季增加 9%至 14%，毛利率約 23%左右，每 ADS 盈餘為 0 至 1 美分（約新台幣 0*至 0.29*元）之間。

產品類別分析（一）-- 大尺寸驅動 IC 產品

2018 年第一季度大尺寸驅動 IC 產品營收淨額為 5,930 萬美元（約新台幣 17 億 3,900 萬元*），較上一季增加 1.6%，較去年同期增加 0.1%，占營收比例 36.4%，此比例上一季為 32.3%，去年同期為 38.2%。由於第一季中國農曆新年假期工作天數較少，通常營收呈現下滑。儘管是傳統淡季，奇景 2018 年第一季度大尺寸營收較上一季個位數微幅增加，主要是全球 4K 電視滲透率持續上升，以及中國客戶持續 LCD 面板廠擴廠。由於中國面板客戶新廠的產能利用率繼續維持高檔，因此在 2018 年第二季，奇景預期大尺寸營收將穩健成長。惟目前整體大尺寸市場正經歷 8 吋晶圓廠產能吃緊情況，而多數大尺寸面板驅動 IC 都是在 8 吋晶圓廠製造的，2018 年第一季奇景大尺寸面板驅動 IC 產品業務成長，受限於 8 吋晶圓廠產能不足，有些訂單無法出貨。在 2018 年第二季，奇景開始使用在中國新建的 12 吋晶圓廠，此新增的晶圓廠產能，將有助緩解奇景客戶缺貨問題，預計開始少量出貨電視相關的驅

動 IC 產品。不過，奇景 12 吋晶圓廠最終出貨進度，將取決於客戶能夠以多快的速度通過其產品驗證，而奇景所有主要客戶正為此加快驗證腳步。隨著 2020 年東京奧運逼近，電視業者正急於開發 8K 解析度超高階電視產品。奇景最近在主要面板廠 8K 電視驗證成功，並預計在未來幾季可貢獻更多營收。奇景預計 2018 年第二季大尺寸營收將較上一季微幅成長，較去年同期兩位數成長。

產品類別分析 (二) -- 中小尺寸驅動 IC 產品

2018 年第一季中小尺寸驅動 IC 產品營收淨額為 7,170 萬美元 (約新台幣 21 億零 300 萬元*)，較上一季減少 11.8%，較去年同期增加 7.6%，占營收比例 44.0%，此比例上一季為 44.9%，去年同期為 42.9%。2018 年第一季中小尺寸驅動 IC 產品營收較上一季減少，主要是由於淡季因素和整體智慧型手機市場銷售疲軟，導致第一季智慧型手機驅動 IC 營收較上一季減少 23.0%，較去年同期減少 5.4%。

中小尺寸驅動 IC 產品 -- 智慧型手機 TDDI

2018 年第一季，儘管受到整體智慧型手機市場疲軟，以及季節性淡季因素，導致智慧型手機驅動 IC 營收出現下滑，但在第二季智慧型手機廠已開始為新產品回補庫存，備貨推出新款手機，奇景將因此受益。總體而言，奇景預計 2018 年第二季智慧型手機業務將較上一季強勁成長。奇景 HD+、FHD+ 和 TDDI 產品將在第二季開始加速出貨，TDDI 的出貨將為奇景帶來新的營收來源。TDDI 的平均銷售單價 (ASP) 及毛利率均高於傳統驅動 IC，預計自 2018 年起，奇景 TDDI 出貨量增加，將改善中小尺寸驅動 IC 產品組合，並對整體營收及獲利產生貢獻。此外，奇景新一代採用 COF 封裝的 FHD + TDDI，已經由中國領先的智慧型手機品牌廠驗證成功，預計在 2018 年下半年開始量產。LCD 顯示器採用 COF 封裝的 TDDI，可以為高階智慧型手機提供超薄的窄邊框設計，比使用 OLED 顯示器類似外形的成本低得多。不過，與大尺寸驅動 IC 產品情況類似，TDDI 市場亦面臨晶圓廠產能吃緊問題，奇景正試圖從現有晶圓廠儘可能爭取更多產能，同時也積極努力尋求 TDDI 其他的晶圓廠產能。奇景預計 TDDI 出貨量將有益於提昇 2018 年營收。

中小尺寸驅動 IC 產品 -- 車用顯示器與平板電腦

奇景 2018 年第一季車用顯示器營收再創歷史新高，較上一季成長 1%，較去年同期增加近 40%。車用顯示器季營收近 2,500 萬美元，占驅動 IC 營收比例約 20%。2018 年第一季奇景平板電腦驅動 IC 營收，較上一季減少 9.2%，較去年同期增加 2.4%，原因是平板電腦整體市場需求疲軟。奇景車用顯示器驅動 IC，前幾年驗證成功的新案，持續進入量產階段。奇景在車用顯示器市場已是市占率領先者，早已成功與世界所有主要面板廠建立長期合作夥伴關係，並將參與終端車商客戶未來幾年內開發的重要新案。2018 年第一季，奇景車用顯示器驅動 IC 營收占總營收比例超過 15%，是全球 TDDI 首次在車用顯示器驗證成功，達到重要的里程碑，奇景的 TDDI 車用顯示器出貨，目標是 2019 年底至 2020 年開始量產。

在 2018 年第二季，由於新智慧型手機的推出、TDDI 出貨量增加，以及車用顯示器驅動 IC 營收的快速成長，奇景預期中小尺寸驅動 IC 產品營收，將較上一季及去年同期均成長約 20%。車用顯示器驅動 IC 較上一季成長約 20%，較去年同期成長約 50%。

產品類別分析 (三) -- 非驅動 IC 產品

2018 年第一季非驅動 IC 產品營收淨額為 3,190 萬美元 (約新台幣 9 億 3,600 萬元*)，較上一季大幅減少 23.2%，較去年同期增加 8.5%，占營收比例 19.6%，此比例上一季為 22.8%，去年同期為 18.9%。雖然開發收入 (NRE) 持續增加，但晶圓級光學鏡頭 (WLO, wafer level optics) 出貨量低於預期，導致 2018 年第一季奇景非驅動 IC 產品營收較上一季大幅減少。不過，2018 年第一季奇景非驅動 IC 產品營收跟去年同期比較還是呈現成長趨勢，主要是 WLO 出貨給頂級客戶，其次是時序控制 IC (TCON, Timing Controller)、CMOS 影像感測器 (CIS, CMOS Image Sensor) 和 NRE 營收增加。奇景預期 WLO 出貨量將在 2018 年第二季增加，並在下半年強勁反彈。

非驅動 IC 產品 -- 無邊框 (Edge to Edge) 螢幕所需新技術：結構光 3D 感測、主動式立體 3D 相機以及光學指紋

目前 Android 智慧型手機市場上，針對無邊框 (Edge to Edge) 螢幕技術有三種主流解決方案，分別是結構光 3D 感測、主動式立體 3D 相機 (ASC, Active Stereoscopic Camera) 以及光學指紋三種，奇景在這三個解決方案都占有獨特的關鍵地位。

目前 3D 感測整體解決方案，主要的目標市場是 Android 的智慧型手機。目前全新的智慧型手機設計具備無邊框螢幕，因為消除 Home 鍵減少邊框區域，把手機螢幕極大化，以提供更好視覺體驗。隨著無邊框螢幕新設計的出現，電容式指紋技術取代傳統的 Home 鍵，隨後用於手機解鎖和線上支付的三種新型生物辨識身分驗證方法因此快速發展。這三種新的 Android 智慧型手機解決方案，是用於臉部辨識的結構光 3D 感測和 ASC，以及用於螢幕下指紋辨識的光學感測器。上述這三種解決方案均各有優勢和挑戰。奇景認為這三種方法均能滿足不同的市場需求，因此可以在市場上共存。結構光 3D 感測提供卓越的深度精準度，但其複雜的發射器設計和製造成本是三者中最高的。而 ASC 解決方案是相對結構光 3D 的較低成本替代方案，為相對簡單的發射器提供了更低成本，並且建立在現有的雙相機鏡頭生態系統之上，但限制是其深度精準度相對有限。第三種的螢幕下指紋辨識和 ASC 解決方案成本相近，是消費者目前已經熟悉的主流電容式指紋最接近的替代方案。然而，螢幕指紋僅限於單一辨識功能，沒有其它應用可能性，例如透過結構光及 ASC 兩種 3D 感測方法可達到的手勢感測、美圖功能及擴增實境（AR），螢幕指紋辨識就做不到。

奇景在上述三種解決方案中均提供關鍵技術，並且在三種方案中，都跟客戶形成不同的協作夥伴關係。奇景提供關鍵技術的角色，代表了龐大營收商機，加上結構光 3D 感測、ASC，及螢幕下指紋辨識三種解決方案的平均銷售單價（ASP）及毛利率，都高於奇景傳統顯示器驅動 IC 業務。業界許多一線領先廠商，都跟奇景上述的三種解決方案合作開發，預計 2018 年底前會陸續出貨。

無邊框（Edge to Edge）螢幕所需的新技術 --（1）結構光 3D 感測（Structured Light 3D Sensing）

奇景於 2017 年 8 月與高通聯合宣布 SLiM™ 整體解決方案（Structured Light Illumination Module），將高通領先業界的 3D 演算法，與奇景先進的繞射光學設計、近紅外光（NIR，Near Infrared）感測器的尖端設計和製造能力，以及獨特 3D 感測系統整合技術相結合，提供市場最高端智慧型手機的 3D 感測需求。SLiM™ 整體解決方案中大部分關鍵技術都是由奇景自行開發提供。這些關鍵技術，包括在發射端，利用奇景領先業界的 WLO 的繞射光學元件（DOE，Diffractive Optics Element）和準直鏡、量身訂作的雷射驅動 IC、雷射投影機組裝所需要的高精密度主動式對準技術（high precision active alignment）、以及在接收端的高性能近紅外光 CMOS 影像感測器（CIS）。奇景還採用高通 3D 深度地圖生成演算法，開發了一款客製化 IC 晶片。所有 SLiM™ 整體解決方案關鍵模組均由奇景內部自行開發，奇景因此具有業界獨特領導地位，任何潛在競爭者進入此領域將面對高門檻挑戰。

奇景與高通聯合宣布推出 3D 感測整體解決方案，是目前 Android 市場上最高品質的 3D 感測解決方案，在 3D 深度精準度、室內及室外靈敏度、功耗需求和所有尺寸，已達到智慧型手機 3D 感測所需要的最佳性能，並通過最嚴格的眼睛安全標準與專有的玻璃破碎檢測機制，以保護用戶免受任何潛在的傷害。奇景 SLiM™ 解決方案，現在已經完成量產與出貨準備。奇景已提供生產樣品給智慧型手機廠，及其臉部辨識和安全線上支付生態系統合作夥伴，以開發旗艦或高級機型的終端產品。由於每個智慧型手機廠的設計及要求均有所不同，這種發展所需時間，比我們預期的長。奇景目標是在 2018 年底開始出貨，以利客戶的智慧型手機能在 2019 年第一季度在市場推出奇景與高通的聯合解決方案。

奇景 SLiM™ 解決方案目前僅適用於高通驍龍（Snapdragon）行動作業平台。配備奇景開發的 3D 深度解碼客製化 IC 晶片，可以將解決方案擴展到更多中高階平台。由於不同應用處理器平台之間的價格差異非常顯著，將使 SLiM™ 解決方案對於智慧型手機廠而言，更加經濟實惠。隨著客製化 IC 晶片處理 3D 深度解碼，智慧型手機應用處理器可以用於其他應用，進而得以使用較少效能之作業平台來應用結構光 3D 感測。

無邊框（Edge to Edge）螢幕所需的新技術 --（2）主動式立體 3D 相機（Active Stereoscopic 3D Sensing）

針對更多大眾市場需求的臉部辨識智慧型手機，奇景推出採用主動式立體相機（ASC，Active Stereoscopic Camera）技術，相對結構光成本較低的 3D 感測解決方案。奇景與領先業界的某大應用處理器 AP 平台公司聯合開發且順利進行中，該合作運用奇景晶圓級光學鏡頭（WLO，Wafer Level Optics）的繞射光學元件（DOE，Diffractive Optics Element）專業知識、主動式對準（active alignment）製造技術和高靈敏度近紅外光（NIR，Near Infrared）感測器。奇景目標是在 2018 年年底讓 ASC 3D 感測解決方案能量產及出貨。ASC 3D 感測解決方案的成本優勢，大大吸引潛在 Android 智慧型手機客戶。雖然與結構光 3D 相比成本較低，ASC 仍將為奇景貢獻高出其他產品的平均銷售單價（ASP）和毛利率。

奇景認為雖然 2018 年 Android 智慧型手機採用 3D 感測數量有限，但預計 2019 年以後市場需求將大幅增加。奇景憑藉領先技術、成熟的製造專業能力、新解決方案產品時程表，以及與領先的應用處理器 AP 供應商結盟，奇景相信有能力成為 3D

感測Android智慧型手機廠的首選合作夥伴。

無邊框 (Edge to Edge) 螢幕所需的新技術 -- (3) 光學指紋 (Optical Fingerprint)

光學指紋是奇景新興的商機，過去兩年，奇景一直與領先業界的某大指紋解決方案供應商，合作開發一款螢幕下光學指紋產品，目標是將光學指紋導入使用OLED顯示器的智慧型手機。目前數個光學指紋新案正在進行驗證，奇景預計將會獲得更多新案。該款光學指紋解決方案，結合了我們合作夥伴的領先指紋解決方案設計和奇景完全為此量身訂做、高靈敏度的超低功耗CMOS影像感測器 (CIS, CMOS image sensor)，可以在極端條件下提供卓越的性能，例如超低光照或陽光直接照射，或手指非常冷或乾時。與在3D感測的經驗類似，光學指紋是全新且複雜的技術，任何潛在競爭者進入此領域將面對高門檻挑戰，該款光學指紋解決方案中使用的CIS，將為奇景貢獻高出傳統顯示器驅動IC產品的平均銷售單價 (ASP) 和毛利率。

非驅動IC產品 -- 晶圓級光學鏡頭 (WLO)

在上次法說會中報告，奇景晶圓級光學鏡頭 (WLO, wafer level optics) 主要客戶，在 2018 年第一季降低預估需求。法說會後，該客戶進一步下修訂單數量，以致奇景 WLO 出貨量大幅減少。由於 WLO 工廠因為產能利用率降低將導致每單位設備折舊和製造成本上升，對奇景第一季毛利率帶來負面影響。從客戶的預估需求來看，奇景 2018 年第二季出貨量，將較第一季增加。儘管出現短期訂單調整，奇景預期 2018 年下半年 WLO 出貨量將會較上半年大幅成長，對於 WLO 客戶的夥伴關係和未來的成長機會，抱持更加樂觀期待。奇景運用在 WLO 技術上的卓越設計及量產專業，正在為特定客戶開發多個新案，用於下一代產品。

非驅動 IC 產品 -- CMOS 影像感測器 (CIS)

在 CMOS 影像感測器 (CIS, CMOS image sensor) 業務，奇景繼續專注於機器視覺領域兩個產品線，即近紅外光 (NIR, Near Infrared) 感測器和全時偵測感測器 (AoS™, Always-on-Sensor)，並獲得巨大進展。奇景的 NIR 感測器，是 SLiM™ 整體解決方案和主動式立體相機 (ASC, Active Stereoscopic Camera) 解決方案的關鍵零組件。奇景的 NIR 感測器具有卓越的量子效率，整體性能遠遠領先同業的 3D 感測應用。在全時偵測感測器產品線方面，奇景在 2018 年 3 月宣布全面收購以色列公司 Emza Visual Sense Ltd. (Emza)。此次收購，將使奇景具有能夠提供超低功耗影像感測解決方案的獨特地位，並配備奇景領先業界的超低功耗 CIS 設計，和 Emza 獨特人工智慧 (AI) 的計算機視覺演算法。此將有助於奇景進入連接家庭、智慧建築和安防監控等消費性電子領域之外的新市場。另外，在傳統人類視覺 CMOS 影像感測器方面，奇景看到筆記型電腦需求強勁，多媒體應用出貨量增加，例如行車紀錄器、安防監控、無人機、家用電器及消費性電子產品等。

非驅動 IC 產品 -- LCOS 微投影解決方案

在LCOS微投影解決方案產品線方面，目前奇景主要專注車用的擴增實境 (AR, Augmented Reality) 眼鏡裝置及抬頭顯示器 (HUD, head-up-displays)。雖然AR還需要幾年時間才能充分證實市場潛力，許多公司，無論是頂尖跨國公司或是新創公司，均持續投入大量研發資源在AR的應用、軟體、操作系統、系統電子和光學等生態系統。奇景積極與多家一線品牌客戶，持續在新技術的工程合作，以期推出下一代智慧眼鏡。此外，LCOS微投影除了應用在AR上，奇景正在開發高階車用抬頭顯示器，並取得重大進展，奇景和合作夥伴一起為多家品牌客戶新案已驗證成功，預計在2019年出貨，為公司營收產生貢獻。LCOS微投影解決方案，為奇景提供一個重要的長期成長機會。

針對非驅動 IC 業務，奇景預期 2018 年第二季較上一季將微幅成長，且較去年同期成長 10%左右。

新廠房和資本支出

奇景在 2017 年宣布一項 8,000 萬美元的資本支出計劃，上次法說會報告將第一階段 8,000 萬美元的預算增加到 1 億零 500 萬美元，第一階段正如期進行。自 2018 年 2 月以來，奇景陸續將設備和與製造相關的員工遷徙至新廠中，並開始調整製造流程，為奇景 3D 感測解決方案進行試產，並已獲得相當令人滿意的產量。在 1 億零 500 萬美元的預算中，2017 年支出 3,300 萬美元，2018 年第一季支出 1,750 萬美元，剩餘的 5,450 萬美元將在 2018 年內支出。第一階段資本支出的資金來源，為奇景內部資金及銀行貸款額度。

流通在外股數

截至 2018 年 3 月 31 日止，奇景期末流通在外股數為約當 1 億 7,210 萬單位 ADS，與 2017 年第四季底維持不變。計算稀釋每股盈餘的股數基礎為約當 1 億 7,250 萬單位 ADS。

線上法說會細節：

網路 www.himax.com.tw 及電話收聽重播，將自線上法說會結束後兩小時開始，至台灣時間 2018 年 5 月 17 日晚上 10 點 59 分（美國東部日光節約時間 2018 年 5 月 17 日上午 10 點 59 分）結束，重播電話專線為+1-855-859-2056（美國本土）或+1-404-537-3406（美國以外），重播確認 ID 號碼為 5288328。至 2019 年 5 月 10 日為止，納斯達克線上法說會可透過 <https://edge.media-server.com/m6/p/wifc44z6> 網路廣播連結，或是奇景光電網站收聽。

關於奇景光電：

本公司係全球顯示器驅動 IC 與時序控制 IC 領先廠商，產品應用於電視、筆記型電腦、桌上型電腦、手機、平板電腦、數位相機、汽車導航、虛擬實境裝置以及其他多種消費性電子產品。奇景光電的其他產品並包含觸控面板控制 IC、手持式與擴增實境裝置使用的頭戴式矽控液晶光閥（LCOS）微型投影解決方案、汽車使用的抬頭顯示器、LED 驅動 IC、電源管理 IC、監視器及投影機控制晶片、客製化影像處理晶片解決方案及提供矽智權的授權等。奇景光電亦提供數位相機解決方案，包括用於擴增實境裝置、3D 感測及機器視覺的 CMOS 影像感測器及晶圓級光學鏡頭，這些產品已被廣泛地應用在手機、平板電腦、筆記型電腦、電視、網路攝影機、汽車、保全、醫療器材及物聯網等。奇景光電設立於 2001 年，總部位於台灣台南，目前員工人數約為 2,150 人，分布於台南、新竹、台北、中國、韓國、日本與美國。至 2018 年 3 月 31 日為止，奇景光電在全球已取得 2,999 項專利，尚有 439 項專利正在申請中，產品應用於全球各種消費性電子品牌產品，技術領先並維持影像顯示處理技術半導體解決方案領導廠商的地位。

聯絡人：

黃華珮 / Jessica Huang
公共關係 專案經理
奇景光電股份有限公司
Himax Technologies, Inc.
+886-3-516-3276 分機 38817
jessica_huang@himax.com.tw

劉欣杰 / Ken Liu
投資人關係 專案副理
奇景光電股份有限公司
Himax Technologies, Inc.
+886-2-2370-3999 分機 22513
ken_liu@himax.com.tw

林芳妃 / Ophelia Lin
投資人關係 專案副處長
奇景光電股份有限公司
Himax Technologies, Inc.
+886-2-2370-3999 分機 22202
ophelia_lin@himax.com.tw

Investor Relations - US Representative
Greg Falesnik, Managing Director
MZ North America
Tel: +1-212-301-7130
Email: greg.falesnik@mzgroup.us
www.mzgroup.us

風險說明：

本新聞稿的部分展望未來的陳述，特別是有關於財務、產業預測，可能會導致實際結果與本新聞稿的描述不同，可能造成差異的因素包括但不限於整體市場與經濟的狀況、半導體產業的狀況、市場對本公司驅動 IC 產品及非驅動 IC 產品之接受度、產品競爭力、市場競爭、終端市場需求、對少數主要客戶的依賴度、持續創新的技術、新面板技術發展、發展與維護智慧財產權的能力、價格壓力如平均售價下滑或客戶訂單模式改變、全年有效稅率預估的改變、面板其他關鍵零組件短缺、政策法規改變、匯率波動、子公司新投資案、對客戶應收帳款的回收與存貨的管理、維護及吸引人才，包括本公司為 2017 年度所申報的 20-F 文件中「風險因素」標題項下的該等風險。不論是否有其他新的訊息或事件，本公司皆無義務公開更新或修改此風險說明。